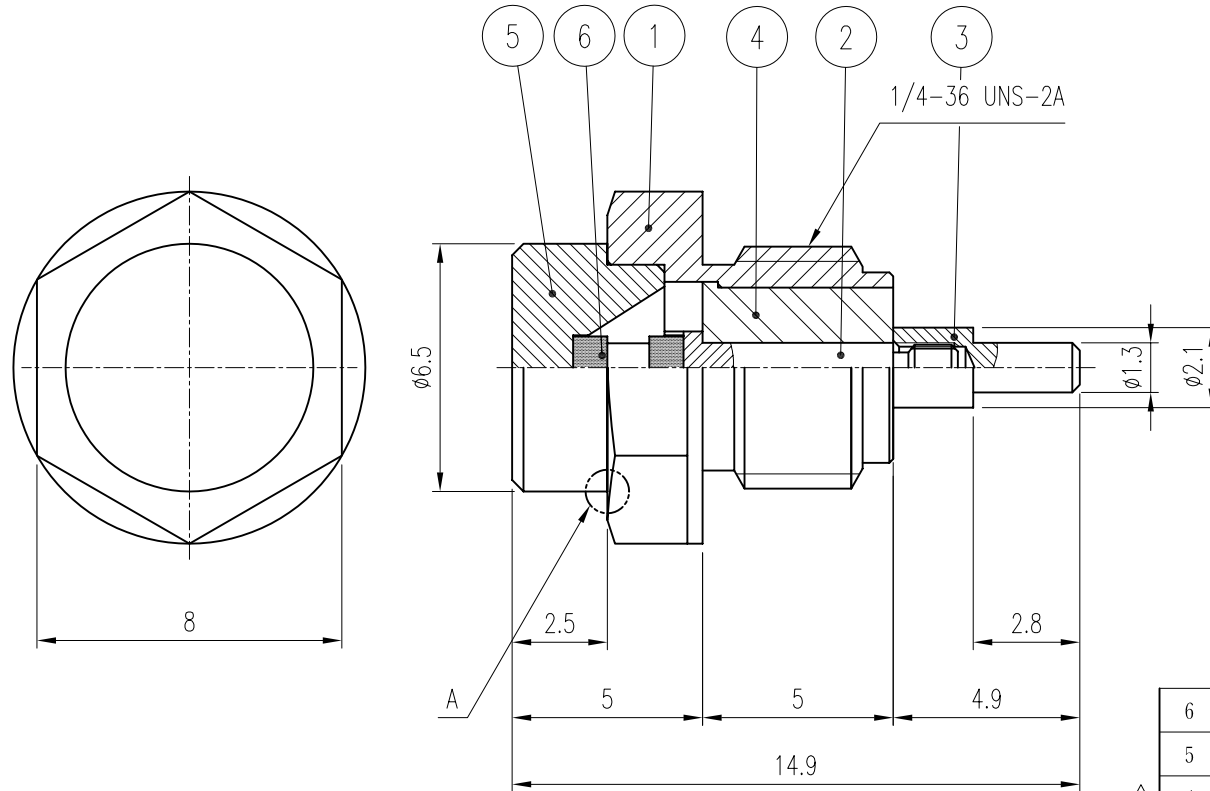


ST	가공	수 정 내 용									
		부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
ST(기준)		1	특성보완 (주기사항 추가)	김은희	안병호	2004.	04.	30.			
ST(개선)		OR	조립성 향상 [설변201004-0019] BODY, INSULATOR 변경으로 인한 설변	강동우	최영호	2010.	04.	21.			



△ 조립 주 기

1. 절연체에 편(A)을 끼우고, 편(B)을 LOCK TITE를 바르고 나사 결합한다.
< 이때 정확히 체결이 되었는지 확인한다-4.9mm 확인>
2. 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것>
5. 표시 된 부분 가차마 작업을 한다.
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.
<저항값 48~50Ω>

6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00013-5/1 (L2032)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00254-N/1 (H2270)
3	CONTACT(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00123-5/1 (E2399)
2	CONTACT(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00122-5/1 (E2398)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01342-5/1 (D2371)
OR					
OR					

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2010. 04. 21.				
소수 각도 분수	승인	Y.H.CHOI				
재질	검도	I.C.KIM				
열처리	제도	D.W.KANG				
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	적도	NS	단위	mm	중량	



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

SMA-J-내장형 TERM

A4

도번 TM00029-7/1
K314-953-000